

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司

关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司（以下简称“子公司”）生产经营和业务发展的需求，公司拟无偿为子公司在 2025 年度向各银行申请总额不超过等值人民币 20,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保。具体担保金额、担保期限等内容由公司及各全资子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，表决结果为：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：无锡麟力科技有限公司

成立日期：2013 年 3 月 12 日

住所：无锡市锡山经济开发区芙蓉中三路 99 号瑞云 3 座

注册地址：无锡市锡山经济开发区芙蓉中三路 99 号瑞云 3 座

注册资本：170,000,000 元

主营业务：集成电路及机电产品的设计、制造、销售、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：刘桂芝

控股股东：上海南麟电子股份有限公司

实际控制人：刘桂芝

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：354,185,968.12 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：180,608,576.09 元

2024 年 12 月 31 日净资产：168,736,519.67 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：52.36%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：64.41%

2024 年营业收入：236,800,208.99 元

2024 年利润总额：-27,389,772.76 元

2024 年净利润：-23,080,259.17 元

审计情况：是

3、被担保人基本情况

名称：上海南麟集成电路有限公司

成立日期：2019 年 11 月 7 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海洋一路 399 号 H3 栋 4 楼
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

注册资本：100,000,000 元
主营业务：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口，货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：刘桂芝
控股股东：上海南麟电子股份有限公司
实际控制人：刘桂芝
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
是否提供反担保：否
关联关系：全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人
2024 年 12 月 31 日资产总额：142,596,089.55 元
2024 年 12 月 31 日流动负债总额：22,364,685.89 元
2024 年 12 月 31 日净资产：120,225,865.81 元
2024 年 12 月 31 日资产负债率：15.69%
2023 年 12 月 31 日资产负债率：27.47%
2024 年营业收入：30,437,491.12 元
2024 年利润总额：-8,896,515.62 元
2024 年净利润：-6,735,048.50 元
审计情况：是

5、被担保人基本情况

名称：无锡麟聚半导体科技有限公司
成立日期：2021 年 1 月 13 日
住所：无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中三路 99 号祥云 4 座 2 楼
注册地址：无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中三路 99 号祥云 4 座 2 楼

注册资本：100,000,000 元

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体分立器件销售；集成电路芯片及产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：刘桂芝

控股股东：上海南麟电子股份有限公司

实际控制人：刘桂芝

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：61,651,610.76 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：10,265,432.63 元

2024 年 12 月 31 日净资产：51,003,318.77 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：17.27%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：21.13%

2024 年营业收入：89,601,306.56 元

2024 年利润总额：-1,375,047.97 元

2024 年净利润：-1,440,124.19 元

审计情况：是

三、担保协议的主要内容

本担保为年度拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为子公司 2025 年度向各银行申请授信额度提供担保旨在满足子公司在生产经营中的资金需求，提高融资效率，支持子公司的发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保涉及的子公司均为公司全资子公司，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，公司为子公司提供担保有利于缓解其资金压力，提高经营效益，不会损害公司利益及股东利益。

（三）对公司的影响

公司为子公司 2025 年度向各银行申请授信额度提供担保有利于增加子公司的资信能力，保障子公司业务的顺利开展。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,500.00	3.68%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

六、备查文件目录

《上海南麟电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日